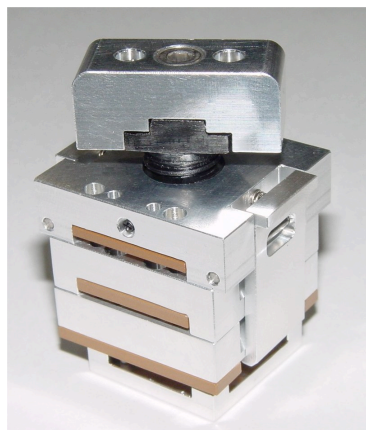




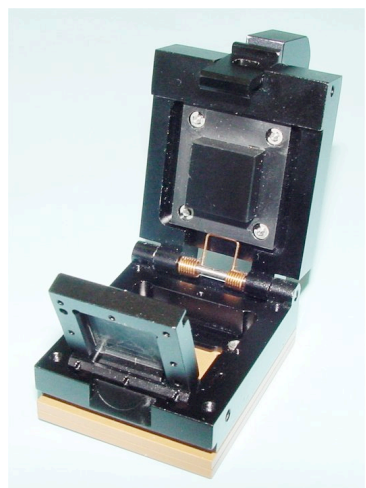
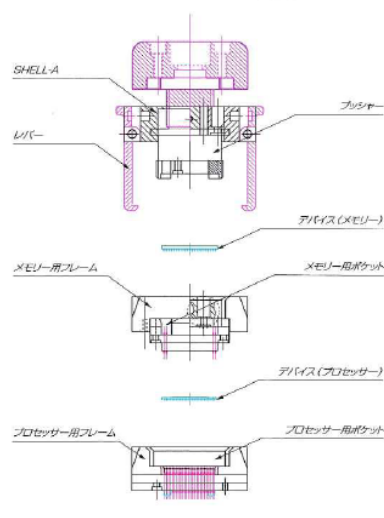
POP 検査用ソケット

PAT. P

携帯電話機に代表される、省スペースで高機能な機器に用いられる半導体実装技術に、POP (Package On Package) があります。
当社では MPU とメモリを半田付けせずに、同時に動作確認できるソケットを用意致しました。



POPテストソケット図



用途

開発段階でのMPU、メモリのデバッグ作業に！
量産時のMPUとDDRメモリの検査用に！
品質管理の抜き取り検査用に！

特長

- MPU・メモリを個別に検査できます。
 - MPU・メモリ間の信号線を引出す事で、特定信号線の解析が可能となります。
※ 仕様等詳細は当社へお問い合わせ下さい。
 - 半田リボール無しでも検査可能です。
不良解析時に半田リボールの必要が無いので、迅速な解析が可能となります。
 - 対応可能チップ、メモリ
- その他は当社へお問い合わせ下さい。

当社のソケット技術

1. チップを壊さない技術

当社が開発した、チップ抑えの独自技術により、薄いチップに対しても破損の危険性を低減させました。

2. 適正な圧力コントロール

当社独自の回転機構付きの構造が、チップの厚み公差や厚さの変更にも対応出来ます。
また、オプションで回転機構のトルク制御が可能となり、チップの破壊を防ぐ効果があります。

注意: 上記仕様は、予告なしに変更されることがあります。詳細はお問い合わせ下さい。